

平成 14年 3月期 決算短信 (連結)

平成 14年 4月 25日

上 場 会 社 名 株式会社日立ハイテクノロジーズ
(旧社名 日製産業株式会社)

上場取引所 東 大
本社所在都道府県
東京都

コード番号 8036
(URL http://www.hitachi-hitec.com/)

問合せ先 責任者役職名 総務部副部長
氏 名 芥川 達哉 TEL (03) 3504 - 5138

決算取締役会開催日 平成 14年 4月 25日
親会社名 株式会社日立製作所 (コード番号: 6501) 親会社における当社の株式保有比率: 72.7 %
米国会計基準採用の有無 無

1. 14年 3月期の連結業績 (平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14年 3月 31日)

(1) 連結経営成績 (記載金額は百万円未満四捨五入表示)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 3月期	738,289	13.0	9,940	32.3	10,321	37.0
13年 3月期	848,700	17.0	14,688	77.5	16,392	63.1

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益	株 主 資 本 当期純利益率	総 資 本 経常利益率	売 上 高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	円 銭	%	%	%
14年 3月期	5,507	28.4	49.71	-	-	4.0	2.8	1.4
13年 3月期	7,691	42.8	87.66	-	-	6.9	5.0	1.9

(注) 持分法投資損益 14年 3月期 159百万円 13年 3月期 863百万円
期中平均株式数(連結) 14年 3月期 110,791,997株 13年 3月期 87,733,961株
会計処理の方法の変更 無
売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 連結財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
14年 3月期	382,533	155,154	40.6	1,127.04
13年 3月期	354,895	117,220	33.0	1,336.04

(注) 期末発行済株式数(連結) 14年 3月期 137,665,231株 13年 3月期 87,736,867株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
14年 3月期	8,824	547	1,139	42,811
13年 3月期	1,097	3,980	3,653	42,995

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 31社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 1社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 23社 (除外) 0社 持分法(新規) 0社 (除外) 15社

2. 15年 3月期の連結業績予想 (平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15年 3月 31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
中間期	376,000	4,380	1,830
通 期	787,000	10,600	5,600

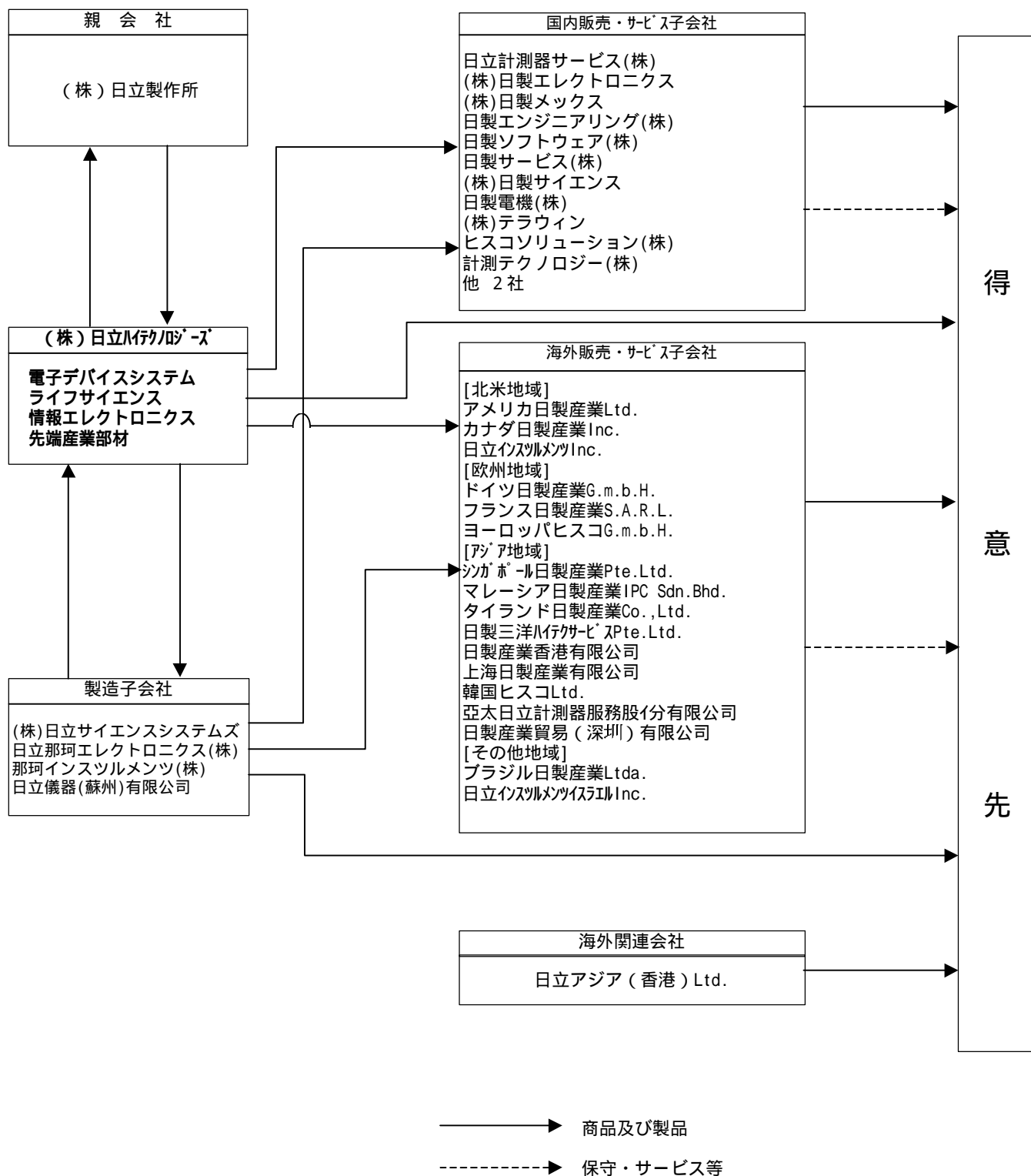
(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 40円68銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

企業集団の状況

当企業グループは当社、子会社34社及び関連会社1社で構成され、当社及び子会社は電子デバイスシステム、ライフサイエンス、情報エレクトロニクス、先端産業部材といったエレクトロニクス関連を中心とする各種商品及び製品の製造販売事業ならびに、それらの取引に関連する保守・サービス等の役務提供を一体とした営業活動として行っております。

各事業の系統図はおおむね共通しており、次の通りであります。



経営方針

1. 連結経営の基本方針

当社グループは、顧客本位主義に基づく「開発」と「堅実経営」を経営の基本とし、顧客の最先端事業活動の要請に対し、的確かつスピーディに応える事業活動を通じて、社会の進歩発展に貢献することを企業活動の基本方針としております。当社は、平成13年10月の株式会社日立製作所の計測器および半導体製造装置グループとの事業統合により獲得した新技術・新製品開発力と、ハイテクノロジー分野において従来から蓄積してきた事業構想力およびグローバルな営業力の強化・融合を図って、「ハイバリュー・クリエイター」としての機能発揮に努めております。

2. 利益配分に関する基本方針

当社は、財務体質と経営基盤の強化を図りながら、株主各位に対する適正な利益の還元を利益配分の基本方針とし、配当性向40%前後を考慮に入れた配当の実施に努めております。当期におきましては、IT関連事業の市況悪化により経常利益・当期利益が業績予想から減少いたしました。1株当たり配当金は業績予想時と同じく7円50銭とし、既に実施した中間配当1株当たり7円50銭と合わせ、年間15円00銭の配当を予定しております。

なお、内部留保金は、商権の確保・拡大と新事業開発の推進、並びに高収益体質の確立と経営効率の向上を図るための投資等に活用し、更なる事業競争力の強化に取り組みます。

3. 中期的な連結経営戦略

当社は、事業統合効果を高め、グループ企業価値の向上を図るため、次の5項目に重点を置いた経営を推進してまいります。

(1) グローバルなハイテクノロジー事業の推進...事業統合により強化された半導体製造装置やバイオ事業等のナノテクノロジー分野において、市場変化・顧客ニーズを迅速に製品開発に結び付け、世界トップ企業を目指します。また、グローバルなネットワークやサービス機能等を強化・活用し、「半導体」「情報・通信」「デジタルメディア」「ライフサイエンス」「環境」等のハイテクノロジー分野で、高付加価値事業を開発します。

(2) 事業投資の積極的推進...他社よりも早く顧客に最適なソリューションを提供するために、研究開発・設備投資を積極的に行うと共に、他社製品のリソースをワールドワイドに求めたM&A、アライアンス等を積極的に推進します。

(3) 経営の効率化とスピード化...市場に直結した経営を行い、事業戦略決定のスピード向上に努めます。また、重複した販売組織や間接部門の整理統合を進めると共に、キャッシュフロー重視の経営を行い、財務体質の強化ならびに高収益を確保できる経営基盤の確立に努めます。

(4) プロフェッショナルな人材の育成...能力主義・成果主義に基づく人事評価制度の推進および適材適所の人材活用により、社員の活力向上を図ります。また、新事業の創造・経営改革を實踐できる人材やグローバル化に対応できる真の国際人の確保・育成に努めます。

(5) 適正な企業行動の推進...株主にとって魅力ある企業となるために、資本効率の向上に努め、株主重視の経営を推進します。また、環境に配慮した経営に取り組み、社会との共生を目指します。

4．会社の対処すべき課題

当社の対処すべき課題は、事業統合効果を早期に実現することです。当社は、製造機能を持つことにより、市場の変化や顧客ニーズをダイレクトに新技術・新製品の開発に結び付け、顧客に最適なソリューションを提供できる「製造・販売・サービス」の一貫体制を構築いたしました。そこで、当社は、事業統合効果を早期に実現するために、製品ラインアップの充実や、顧客ベースの増加、および日立製作所の持つ研究開発機能の活用など、事業統合により獲得したメリットを存分に活かして受注の拡大に努めると共に、業務プロセスの改善や、より効果的な組織運営を目指した組織のスリム化などにより軽量経営を促進して、業容の拡大および収益の向上を目指してまいります。なお、株式の流動性を高め投資家の拡大を図ることも当社の対処すべき課題の一つとして認識しております。市場の動向を見守りながら、最適な方法を検討してまいります。

経営成績及び財政状態

1. 経営成績

(1) 当期の概況

当期(平成13年4月～平成14年3月)の経営成績は、売上高738,289百万円(前期比13.0%減)、経常利益10,321百万円(同37.0%減)、当期純利益は5,507百万円(同28.4%減)となりました。

次に事業の種類別セグメントの営業概況を述べます。

電子デバイスシステム部門

半導体製造装置については、事業統合により新たに販売を開始した欧米向けのエッチング装置が好調に推移しました。また、新製品開発や新規顧客開拓により、電子線描画装置や外観検査装置も堅調に推移しました。

一方で、世界的な半導体業界の設備投資抑制の影響により、主力の測長SEMが大きく落ち込んだ他、国内及びアジア向けのエッチング装置も苦戦し、セグメント全体では減少となりました。

以上の結果、当部門の売上高は126,258百万円、営業利益は3,430百万円となりました。

ライフサイエンス部門

医用分析装置については、欧米向けの血液自動分析装置が医療費抑制の影響を受けて減少しましたが、開発を進めている免疫自動分析装置や、新市場の中国向けは順調に推移しました。

また、事業統合により販売を開始した国内向けの医用分析装置や、米国向けのDNAシーケンサが堅調に推移し、セグメント全体では増加となりました。

以上の結果、当部門の売上高は79,024百万円、営業利益は3,172百万円となりました。

情報エレクトロニクス部門

携帯電話市場の冷え込みにより、電子部品実装装置や半導体デバイスが大きく落ち込みました。また、価格競争の厳しいカラーディスプレイ管も大幅な減少となりました。

一方で、有機EL製造装置や、DVD用ピックアップ、情報家電など携帯電話以外のIT関連製品については堅調に推移しましたが、全体の落ち込みをカバーするには到りませんでした。

以上の結果、当部門の売上高は281,593百万円、営業利益は3,265百万円となりました。

先端産業部材部門

世界的なIT不況の波を受け、光波長分割多重(WDM)システムなどに使われる光通信部品が大きく落ち込んだほか、シリコンウエハーや基板材料も苦戦いたしました。

PC関連製品や液晶プロジェクタ用光学部品が健闘したものの、セグメント全体では減少となりました。

以上の結果、当部門の売上高は251,413百万円、営業利益は235百万円となりました。

(2) 次期の見通し

半導体をはじめとするIT分野には曙光が見え始めております。このような環境下、当社は、平成15年3月期(平成14年度)で、売上高787,000百万円(前期比6.6%増)、経常利益10,600百万円(同2.7%増)、当期純利益5,600百万円(同1.7%増)の通期業績目標を設定いたしました。

今後とも、事業統合によるシナジー効果を最大限に発揮し、高成長分野へ経営資源を集中投入して、業績目標の達成を目指してまいります。

2. キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は42,811百万円となり、前連結会計年度末より184百万円減少いたしました。これは、新規連結及び吸収分割による連結子会社の増加により現金及び現金同等物が各々、3,814百万円、1,759百万円増加したものの、営業活動によるキャッシュ・フロー等が5,759百万円減少したことによります。

次に各キャッシュ・フローの状況とその主な要因を述べます。

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、8,824百万円の減少となりました。これは主に税金等調整前当期純利益10,321百万円、減価償却費4,882百万円、売上債権の減少額47,784百万円等による増加と、仕入債務の減少額68,691百万円、法人税等の支払額9,898百万円等による減少によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、547百万円の増加となりました。これは主に有価証券の売却による収入4,509百万円、投資有価証券の売却による収入1,814百万円、設備投資や営業権取得等の有形・無形固定資産の取得による支出5,204百万円によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,139百万円の増加となりました。これは主に短期借入金の増加による収入3,450百万円、配当金の支払による支出2,193百万円によるものです。

連 結 損 益 計 算 書

(単位 百万円)

科 目	平成 14 年 3 月 期 〔自平成13年4月 1日 至平成14年3月31日〕	平成 13 年 3 月 期 〔自平成12年4月 1日 至平成13年3月31日〕	前 年 度 比 較 増 減 率 (%)
売 上 高	738,289	848,700	13.0
売 上 原 価	662,257	787,632	15.9
売 上 総 利 益	76,032	61,068	24.5
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	66,092	46,380	42.5
営 業 利 益	9,940	14,688	32.3
営 業 外 収 益	2,268	3,153	28.1
(受 取 利 息)	(1,047)	(1,763)	(40.6)
(受 取 配 当 金)	(160)	(154)	(4.2)
(持 分 法 に よ る 投 資 利 益)	(159)	(863)	(81.6)
(雑 収 益)	(902)	(373)	(141.8)
営 業 外 費 用	1,887	1,449	30.2
(支 払 利 息)	(183)	(146)	(25.4)
(雑 損 失)	(1,703)	(1,303)	(30.7)
経 常 利 益	10,321	16,392	37.0
特 別 利 益	-	1,990	-
(土 地 売 却 益)	(-)	(1,990)	(-)
特 別 損 失	-	4,612	-
(退職給付会計基準変更時差異償却額)	(-)	(4,612)	(-)
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	10,321	13,770	25.0
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	4,574	9,717	52.9
法 人 税 等 調 整 額	108	3,662	-
少 数 株 主 利 益	132	24	449.0
当 期 純 利 益	5,507	7,691	28.4

連結剰余金計算書

(単位 百万円)

科 目	平成14年3月期 〔 自平成13年4月 1日 至平成14年3月31日 〕		平成13年3月期 〔 自平成12年4月 1日 至平成13年3月31日 〕	
	連結剰余金期首残高			
連結剰余金期首残高	96,084		91,044	
吸収分割による連結子会社増加に伴う期首剰余金増加額	7,568	103,652	-	91,044
連結剰余金減少高				
配 当 金	2,193		2,413	
取 締 役 賞 与	233	2,426	238	2,651
当 期 純 利 益		5,507		7,691
連結剰余金期末残高		106,733		96,084

連結売上高内訳

(単位 百万円)

期 別 事業の種類	平成14年3月期 〔 自平成13年4月 1日 至平成14年3月31日 〕		平成13年3月期 〔 自平成12年4月 1日 至平成13年3月31日 〕		前年度比較 増 減 率 (%)
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	
電子デバイスシステム	126,258	17.1	133,256	15.7	5.3
ライフサイエンス	79,024	10.7	62,759	7.4	25.9
情報エレクトロニクス	281,593	38.1	345,752	40.7	18.6
先端産業部材	251,413	34.1	306,934	36.2	18.1
合 計	738,289	100.0	848,700	100.0	13.0

連結貸借対照表

(単位 百万円)

科 目	平成14年 3月期 〔平成14年 3月31日〕	平成13年 3月期 〔平成13年 3月31日〕	増減額	科 目	平成14年 3月期 〔平成14年 3月31日〕	平成13年 3月期 〔平成13年 3月31日〕	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	274,386	268,810	5,576	流動負債	199,766	223,422	23,656
現金及び預金	43,193	43,563	370	支払手形及び買掛金	129,371	188,790	59,419
受取手形及び売掛金	177,127	193,240	16,113	短期借入金	29,425	2,557	26,868
有価証券	2,098	4,417	2,319	未払法人税等	2,805	7,082	4,277
たな卸資産	37,448	18,407	19,041	未払費用	19,416	6,920	12,496
繰延税金資産	8,036	5,079	2,957	前受金	9,579	12,236	2,657
前渡金	2,917	2,813	104	その他	9,172	5,837	3,335
その他	5,663	3,180	2,483	固定負債	24,566	14,048	10,518
貸倒引当金	2,095	1,889	206	繰延税金負債	-	907	907
固定資産	108,147	86,085	22,062	退職給付引当金	23,283	12,246	11,037
有形固定資産	56,584	32,619	23,965	役員退職慰労引当金	1,157	895	262
建物及び構築物	19,436	10,407	9,029	その他	126	-	126
機械装置及び運搬具	8,854	351	8,503	負債合計	224,332	237,470	13,138
工具器具備品	6,616	2,247	4,369				
土地	20,842	19,614	1,228				
建設仮勘定	836	-	836	【少数株主持分】			
無形固定資産	3,187	387	2,800	少数株主持分	3,047	205	2,842
営業権及び特許権	1,371	-	1,371				
ソフトウェア	1,574	272	1,302	【資本の部】			
その他	241	115	126	資本金	7,938	5,438	2,500
投資その他の資産	48,376	53,079	4,703	資本準備金	35,723	9,695	26,028
投資有価証券	31,328	41,027	9,699	連結剰余金	106,733	96,084	10,649
長期貸付金	1,817	3,557	1,740	その他有価証券評価差額金	4,581	6,645	2,064
その他	8,523	7,248	1,275	為替換算調整勘定	290	639	929
繰延税金資産	8,137	2,582	5,555	自己株式	111	3	108
貸倒引当金	1,429	1,335	94	資本合計	155,154	117,220	37,934
資産合計	382,533	354,895	27,638	負債、少数株主持分及び資本合計	382,533	354,895	27,638

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

科 目	平成14年3月期 自平成13年4月 1日 至平成14年3月31日	平成13年3月期 自平成12年4月 1日 至平成13年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	10,321	13,770
減価償却	4,882	1,966
退職給与引当金の減少額	-	6,284
退職給付引当金の増減額	317	12,246
各種引当金の増減額	10	1,297
受取利息及び受取配当	1,207	1,917
支払利息	183	146
土地売却益	-	1,990
その他の収益・費用の非資金分類	402	551
役員賞与の支払額	233	180
売上債権の増減額	47,784	30,079
たな卸資産の増減額	3,732	5,419
仕入債務の増減額	68,691	22,241
その他の資産及び負債の増減額	3,594	511
その他	467	18
小計	27	4,717
利息及び配当金の受取額	1,277	1,941
利息の支払額	175	146
法人税等の支払額	9,898	5,415
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,824	1,097
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	382	483
定期預金の払出による収入	568	-
有価証券の取得による支出	101	1,999
有価証券の売却による収入	4,509	3,273
投資有価証券の取得による支出	184	8,059
投資有価証券の売却による収入	1,814	2,000
有形・無形固定資産の取得による支出	5,204	2,065
有形・無形固定資産の売却による収入	56	2,233
貸付による支出	530	1,500
貸付の回収による収入	-	1,000
その他の投資の取得による支出	-	200
その他の投資の売却による収入	-	1,820
投資活動によるキャッシュ・フロー	547	3,980
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	3,450	1,233
配当金の支払額	2,193	2,413
その他	117	7
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,139	3,653
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,379	1,271
現金及び現金同等物の減少額	5,759	5,265
現金及び現金同等物の期首残高	42,995	48,260
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,814	-
吸収分割による連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,759	-
現金及び現金同等物の期末残高	42,811	42,995

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書の は、現金及び現金同等物の流出を示しております。

連結貸借対照表の現金及び預金残高と連結キャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物期末残高との調整

(単位 百万円)

現金及び預金	43,193	43,563
預入れ期間が3ヶ月を超える定期預金	382	568
現金及び現金同等物	42,811	42,995

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲

(1) 連結子会社数 31 社

会社名：日立計測器サービス(株)、(株)日製エレクトロニクス、(株)日製メックス、日製エンジニアリング(株)、アメリカ日製産業 Ltd.、ドイツ日製産業 G.m.b.H.、シンガポール日製産業 Pte.Ltd.、日製産業香港有限公司、他 23 社

前連結会計年度まで非連結子会社として持分法を適用していた日製電機(株)他 13 社については、財務内容の開示をより充実する観点より当連結会計年度から連結の範囲に含めることといたしました。

なお、平成 13 年 10 月 1 日付で株式会社日立製作所の計測器事業及び半導体製造装置事業を吸収分割により承継したことにより、当連結会計年度において株式会社日立サイエンスシステムズ他 6 社を新たに連結子会社に含めております。

また、当連結会計年度にヒスコソリューション株式会社及びヨーロッパヒスコ G.m.b.H. を設立し連結子会社に含めております。

(2) 非連結子会社数 3 社

当連結会計年度に新たに設立した 2 社ならびに吸収分割により承継した 1 社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純利益(持分に見合う額)及び剰余金(持分に見合う額)はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用

(1) 持分法適用の関連会社数 1 社

日立アジア(香港)Ltd.に対する投資については持分法を適用しております。

なお、前連結会計年度まで持分法適用関連会社としていた日立インストルメンツ Inc.は、事業統合により当該会社に対する当社の影響力が増大することから実質支配力基準を適用し連結子会社に変更いたしました。

(2) 持分法適用の非連結子会社数 なし

非連結子会社 3 社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純利益(持分に見合う額)及び剰余金(持分に見合う額)はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計処理基準

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの：連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

また、売却原価は移動平均法により算定しております。

(評価差額は全部資本直入法により処理しております。)

時価のないもの：移動平均法による原価法によっております。

たな卸資産

商 品：

主として移動平均法による原価法によっております。

製品・半製品・材料：

主として移動平均法による低価法によっております。

仕掛品：

主として個別法による低価法によっております。

デリバティブ

時価法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

主として定率法によっております。但し、レンタル資産についてはレンタル期間に応じた定額法、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法によっております。

また、平成 13 年 10 月 1 日付で吸収分割により承継した建物については、定額法によっております。

無形固定資産

定額法によっております。但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5 年）に基づく定額法、市場販売目的のソフトウェアについては見込販売数量に基づく償却方法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失等に備えるため、主として一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金

当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（7年～18年）による定額法により、翌連結会計年度より費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規則に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

当社及び国内連結子会社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、在外連結子会社については主として通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約取引等

ヘッジ対象：外貨建予定取引残高の為替相場変動によるキャッシュ・フロー変動

リスク

ヘッジ方針

当社及び連結子会社は、その企業行動基準の基本理念である堅実経営の精神に則り、外貨建取引のうち、当社に為替変動リスクが帰属する場合は、そのリスクヘッジのため、実需原則に基づき成約時に為替予約取引を行うものとしております。

ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ有効性の評価は、原則としてヘッジ開始時から有効性評価時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております

5. 連結子会社の資産及び負債の評価

部分時価評価法を採用しております。

6. 連結調整勘定の償却

僅少なものについては発生年度に全額償却しております。

7. 利益処分項目等の取扱い

連結剰余金計算書は連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しています。

8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）の範囲は手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。

<注 記 事 項>

(貸借対照表関係)

	(平成 14年3月期)	(平成 13年3月期)
1.有形固定資産の減価償却累計額	54,722 百万円	13,292 百万円
2.保証債務	2,266 百万円	975 百万円
3.輸出手形割引高	956 百万円	1,329 百万円
4.受取手形裏書譲渡高	281 百万円	280 百万円
5.自己株式	73,499株	1,863株

(リース取引関係)

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	(平成 14年3月期)	(平成 13年3月期)
取得価額相当額	3,650 百万円	1,480 百万円
減価償却累計額相当額	1,394 百万円	686 百万円
期末残高相当額	2,255 百万円	794 百万円

上記金額のうち、主なものは「工具器具備品」であります。

未経過リース料期末残高相当額

	(平成 14年3月期)	(平成 13年3月期)
1 年 内	834 百万円	307 百万円
1 年 超	1,441 百万円	495 百万円
合 計	2,275 百万円	802 百万円

支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

	(平成 14年3月期)	(平成 13年3月期)
支払リース料	842 百万円	374 百万円
減価償却費相当額	817 百万円	359 百万円
支払利息相当額	27 百万円	14 百万円

なお、減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。また利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

2.オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料

	(平成 14年3月期)	(平成 13年3月期)
1 年 内	56 百万円	32 百万円
1 年 超	76 百万円	45 百万円
合 計	132 百万円	77 百万円

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

2. 退職給付債務に関する事項(平成14年3月31日現在)

退職給付引当金	23,283 百万円
---------	------------

3. 退職給付費用に関する事項(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)

勤務費用	2,406 百万円
利息費用	2,667 百万円
期待運用収益(減算)	1,724 百万円
会計基準変更時差異の費用処理額(減算)	37 百万円
数理計算上の差異の償却額	639 百万円

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
割引率	各制度ごとに退職給付の見込み支払日までの平均期間に基づいて設定しております。 2.7~4.4%
期待運用収益率	3.0~4.5%
数理計算上の差異の処理年数	7年~18年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。)
会計基準変更時差異の処理年数	発生した連結会計年度で一括費用処理しております。ただし、平成13年10月1日の吸収分割で承継した退職給付債務にかかる会計基準変更時差異については5年で費用処理する事としております。

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

平成14年3月期（自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日）

（単位 百万円）

セグメント 科 目	電子 デバイスシステム	ライフサイエンス	情報 エレクトロニクス	先端産業 部材	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	126,258	79,024	281,593	251,413	738,289	-	738,289
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	1,845	640	537	2,740	5,762	(5,762)	-
計	128,103	79,664	282,130	254,154	744,051	(5,762)	738,289
営業費用	124,674	76,491	278,866	253,919	733,949	(5,600)	728,349
営業利益	3,430	3,172	3,265	235	10,102	(162)	9,940

- (注) 1. 事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。
2. 各事業の主な商品・製品
- (1)電子デバイスシステム
半導体製造装置、半導体工程検査装置、電子顕微鏡、液晶関連装置 他
- (2)ライフサイエンス
質量分析計、核磁気共鳴装置、分光光度計、クロマトグラフ、遠心機等の各種分析計測機器
バイオ関連機器、医用分析機器 他
- (3)情報エレクトロニクス
計装機器および関連システム、自動組立システム、自動車用各種計測・検査機器
発・変電システム、研究試験設備、コンピュータシステム、周辺機器、OA関連機器、
半導体・集積回路、液晶表示装置、その他各種電子部品、民生用情報機器 他
- (4)先端産業部材
光通信部材、光ストレージ部材、電子材料、基板材料、鉄鋼製品、非鉄金属製品
その他化成品、建設資材
3. 従来、事業の種類別セグメント情報については、「科学・生産システム」「情報エレクトロニクス」「先端産業部材」の3区分にて表示していましたが、平成13年10月1日付で株式会社日立製作所の計測器事業及び半導体製造装置事業を吸収分割により事業統合し、従来の商社機能に加え新たに製造機能を有することとなったことを受け、当社及び連結子会社の事業活動に対する関係者のご理解を一層深めて頂くため当連結会計年度より「電子デバイスシステム」「ライフサイエンス」「情報エレクトロニクス」「先端産業部材」の4区分にて表示することに変更いたしました。

平成13年3月期（自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日）

当社及び連結子会社は、国内及び海外におけるエレクトロニクス関連商品を中心とする各種商品及びシステム製品の売買ならびに、それらの取引に関連する保守・サービス等の役務提供を、一体とした営業活動として行っております。

なお、従来、事業の種類別セグメント情報については、単一の事業分野に属しているものとして記載を省略しておりましたが、当社及び連結子会社の事業活動に対する関係者のご理解を一層深めていただくため、当連結会計年度より社内管理上使用している事業区分を用いてセグメント情報を記載することといたしました。

（単位 百万円）

科 目 \ セグメント	科学・生産システム	情報 IT/IT/IT	先端産業 部材	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	293,843	254,275	300,582	848,700	-	848,700
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	769	564	303	1,636	(1,636)	-
営業費用	294,612	254,839	300,885	850,336	(1,636)	848,700
営業利益	285,379	253,401	296,874	835,654	(1,642)	834,012
営業利益	9,233	1,438	4,011	14,682	6	14,688

（注） 1．事業の区分は社内管理上使用している区分によっております。

2．各事業の主な商品

(1)科学・生産システム

電子顕微鏡等の各種分析計測機器、バイオ関連機器、医用分析機器、計装機器および関連システム、環境計測機器、半導体製造装置、半導体工程検査装置 他

(2)情報エレクトロニクス

コンピュータシステム、周辺機器、OA関連機器、電子管、半導体・集積回路、その他各種電子部品、民生用情報機器 他

(3)先端産業部材

光通信部材、電子材料、基板材料、鉄鋼製品、非鉄金属製品 他

2. 所在地別セグメント情報

(単位 百万円)

期 別 科 目	平成14年3月期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)							
	セグメント 日 本	北 米	欧 州	ア ジ ア	そ の 他	計	消去又は 全社	連 結
. 売上高及び営業損益								
売 上 高								
(1)外部顧客に対する売上高	527,264	97,591	56,774	56,660	-	738,289	-	738,289
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	71,238	2,883	4,164	7,765	28	86,078	(86,078)	-
計	598,502	100,473	60,939	64,425	28	824,367	(86,078)	738,289
営 業 費 用	590,229	100,118	60,526	62,988	46	813,906	(85,558)	728,349
営 業 利 益	8,273	355	413	1,437	(18)	10,460	(520)	9,940
. 資 産	339,886	30,396	15,790	16,890	128	403,089	(20,556)	382,533

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分方法.....地理的近接度による。

(2) 各区分に属する主な国又は地域.....北 米 : 米国

欧 州 : ドイツ、イギリス

アジ ア : シンガポール、香港、台湾、韓国、中国

そ の 他 : ブラジル

(単位 百万円)

期 別 科 目	平成13年3月期 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)						
	セグメント 日 本	北 米	欧 州	ア ジ ア	計	消去又は 全社	連 結
. 売上高及び営業損益							
売 上 高							
(1)外部顧客に対する売上高	613,444	113,389	77,493	44,374	848,700	-	848,700
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	58,229	1,854	3,642	11,988	75,713	(75,713)	-
計	671,673	115,243	81,135	56,362	924,413	(75,713)	848,700
営 業 費 用	661,582	113,746	79,350	54,957	909,635	(75,623)	834,012
営 業 利 益	10,091	1,497	1,785	1,405	14,778	(90)	14,688
. 資 産	305,477	29,368	20,262	12,992	368,099	(13,204)	354,895

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分方法.....地理的近接度による。

(2) 各区分に属する主な国又は地域.....北 米 : 米国

欧 州 : ドイツ、イギリス

アジ ア : シンガポール、香港、台湾、韓国

3. 海外売上高

(単位 百万円)

期 別 科 目	平成14年3月期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)				
	北 米	欧 州	ア ジ ア	その他の地域	計
セグメント ・ 海 外 売 上 高	111,591	63,724	156,270	5,513	337,099
・ 連 結 売 上 高					738,289
・ 連結売上高に占める海外売上高の割合	15.1%	8.6%	21.2%	0.7%	45.6%

- (注) 1. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
 2. 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域
 (1) 国又は地域の区分方法.....地理的近接度による。
 (2) 各区分に属する主な国又は地域.....北 米 : 米国、カナダ
 欧 州 : ドイツ、イギリス
 アジア : シンガポール、香港、台湾、韓国、中国
 その他の地域 : 中近東、中南米

(単位 百万円)

期 別 科 目	平成13年3月期 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)				
	北 米	欧 州	ア ジ ア	その他の地域	計
セグメント ・ 海 外 売 上 高	122,107	92,347	185,289	3,409	403,152
・ 連 結 売 上 高					848,700
・ 連結売上高に占める海外売上高の割合	14.4%	10.9%	21.8%	0.4%	47.5%

- (注) 1. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
 2. 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域
 (1) 国又は地域の区分方法.....地理的近接度による。
 (2) 各区分に属する主な国又は地域.....北 米 : 米国、カナダ
 欧 州 : ドイツ、イギリス
 アジア : シンガポール、香港、台湾、韓国
 その他の地域 : ブラジル

有 価 証 券

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位 百万円)

区 分	当連結会計年度 平成14年3月31日現在			前連結会計年度 平成13年3月31日現在		
	取得原価	連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額	差 額	取得原価	連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額	差 額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの						
株 式 債 券	1,977	9,812	7,835	2,591	13,746	11,155
金 融 債 券	1,002	1,005	3	2,207	2,229	22
社 債	9,000	9,149	149	12,703	12,979	275
そ の 他	5,500	5,526	26	8,600	8,671	71
小 計	17,479	25,492	8,013	26,101	37,624	11,523
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの						
株 式 債 券	1,221	1,176	45	1,097	1,029	68
金 融 債 券	-	-	-	500	499	0
そ の 他	3,000	2,908	92	-	-	-
小 計	4,221	4,084	137	1,596	1,529	68
合 計	21,700	29,577	7,876	27,697	39,153	11,456

2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位 百万円)

区 分	当連結会計年度 平成14年3月31日現在		前連結会計年度 平成13年3月31日現在	
	連結貸借対照表計上額		連結貸借対照表計上額	
その他有価証券				
非上場株式(店頭売買株式を除く)		466		523
非上場外国債券		1		-
公社債投資信託		92		-
合 計		559		523

3. その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額

(単位 百万円)

区 分	当連結会計年度 平成14年3月31日現在				前連結会計年度 平成13年3月31日現在			
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
債 券								
金 融 債 券	1,005	-	-	-	1,711	1,017	-	-
社 債	1,001	1,016	1,018	-	2,706	2,037	2,039	-
そ の 他	92	5,526	2,908	-	-	5,646	3,025	-
合 計	2,098	6,542	3,927	-	4,417	8,700	5,064	-

関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	(株)日立製作所	東京都千代田区	282,032	電気機械器具の製造及び販売	直接 72.3% 間接 0.4%	兼任3人	理化学機器・電子機器等の仕入 各種機器・材料等の販売	各種機器・材料等の販売	93,581	売掛金	14,972
										前受金	508
								理化学機器・電子機器等の仕入	104,705	買掛金	15,807
										前渡金	543
						吸収分割					
							承継資産合計	86,790			
							承継負債合計	58,262			

(注)取引条件ないし取引条件の決定方針等

- 各種機器・材料等の販売については、毎期価格交渉の上、一般取引条件と同様に決定しております。
理化学機器・電子機器の仕入の価格その他の取引条件については、個別に交渉の上、一般取引条件と同様に決定しております。
- 吸収分割については、親会社の計測器グループと半導体製造装置グループに関する営業を承継したものであり、分割に際して、当社から親会社に対して新株式50,000,000株を発行し、そのすべてを割当て交付しております。
なお、その算定方法については、親会社、当社ともにそれぞれ異なる第三者機関に算定を依頼し、その結果を参考にして、親会社および当社で協議の上決定しております。
- 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、残高は消費税等を含んで表示しております。